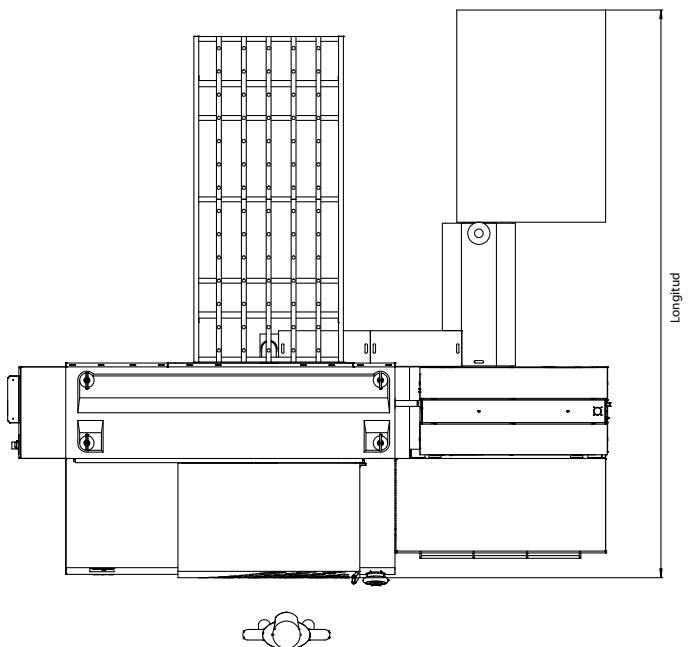
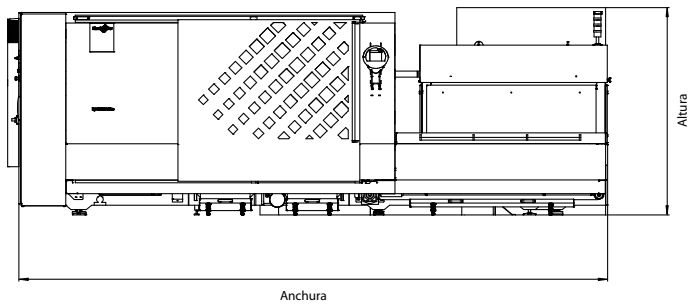


Datos técnicos ByVention 3015

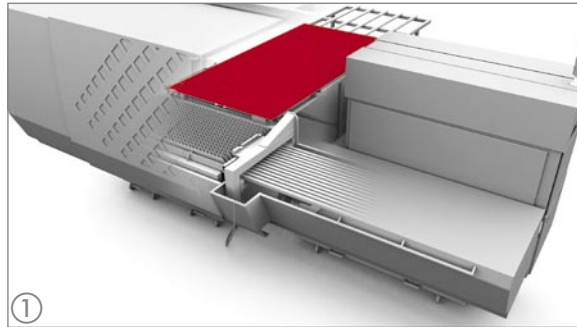


ByVention 3015

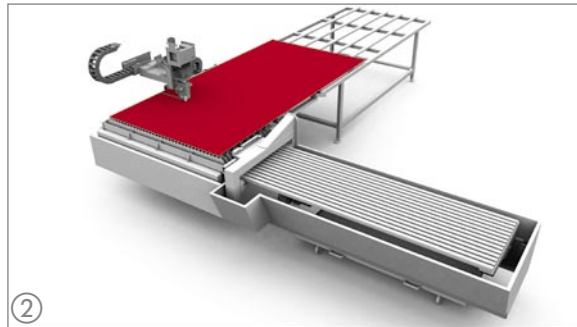
Potencia del láser	2200 W	4400 W
Longitud	6000 mm	6000 mm
Anchura	6000 mm	6400 mm
Altura	2150 mm	2150 mm

Innovador concepto de flujo de material

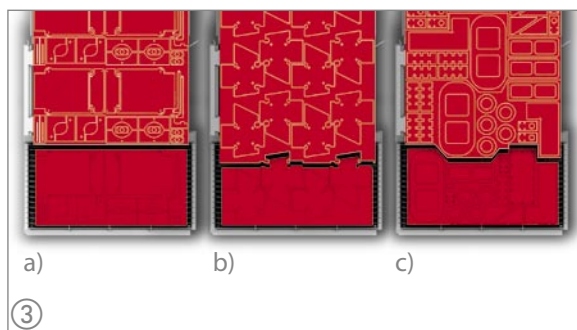
ByVention es la instalación de corte por láser más pequeña para formatos de chapa estándar. Gracias a su innovador e inteligente concepto de flujo de material, las piezas fabricadas son transportadas desde la zona de corte de modo continuo y automático. El usuario puede disponer de ellas durante el mismo proceso de corte. El proceso de retirada de las piezas es fácil y cómodo. La zona de retirada presenta una accesibilidad total.



La plancha de chapa se coloca manualmente en la mesa de carga y se desliza hasta el tope.



La plancha se introduce automáticamente en la zona de corte. Se cortan las piezas dentro del primer segmento.



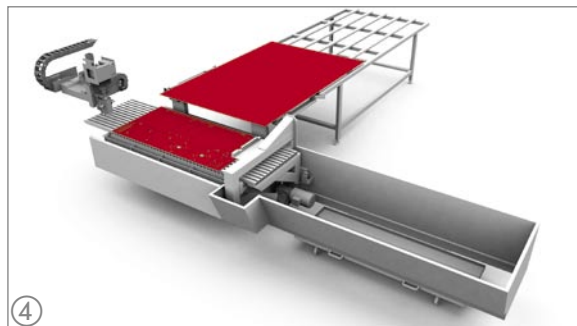
ByVention divide la chapa en segmentos que son elaborados sucesivamente. Existen **tres** estrategias diferentes para intercalar las piezas en la chapa.

a) Estrategia sin solapado

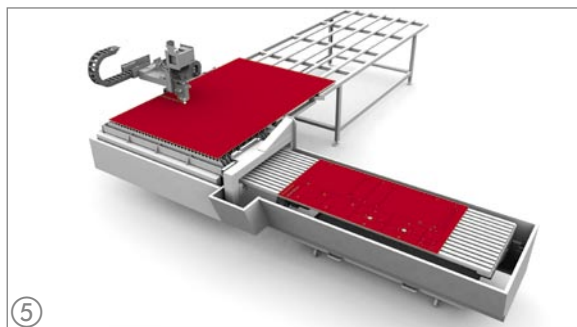
Esta estrategia es adecuada para piezas que pueden intercalarse de forma óptima dentro de un rectángulo. El segmento se separa con un corte recto antes de cortar las piezas. La longitud máxima del segmento corresponde con la longitud de la zona de corte (772 mm).

b) Estrategia con solapado y corte de separación parcial

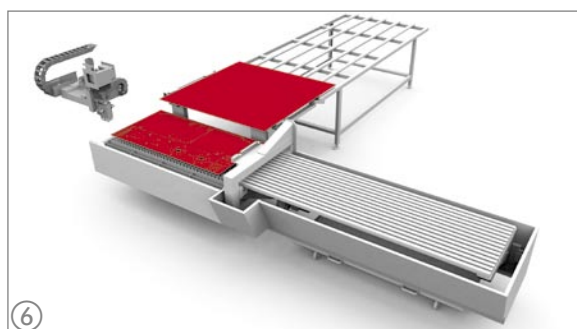
Esta estrategia permite el aprovechamiento de las chapas cuando las piezas no pueden intercalarse de forma óptima dentro de un rectángulo. El corte de separación coincide parcialmente con los contornos exteriores y, por tanto, no tiene un trazado recto. Los segmentos se acoplan entre sí. Todas las piezas de un segmento se encuentran dentro de una zona del segmento de 772 mm sobre 1562 mm.



El siguiente segmento de chapa acabado se coloca automáticamente en la mesa de retirada.



La mesa de retirada conduce automáticamente el segmento de chapa acabado desde la zona de corte a la zona de retirada. Al mismo tiempo la plancha se introduce en la zona de corte para que pueda cortarse el próximo segmento. Las piezas cortadas así como el resto de la chapa se extraen manualmente de la zona de retirada.



El segmento de chapa acabado se coloca automáticamente en la mesa de retirada. El mismo procedimiento se repite hasta elaborar toda la plancha. En cuanto el último segmento de la plancha se encuentre en la zona de corte, puede colocarse una nueva plancha en la mesa de carga.

El software de corte y plegado Bysoft de Bystronic facilita los procesos de ByVention y selecciona automáticamente a partir de la programación la estrategia óptima para la segmentación de la chapa.

c) Estrategia con solapado y corte de separación total

Esta estrategia puede utilizarse como alternativa a la estrategia b), en especial para grosores de chapa a partir de 3 milímetros, piezas con formas complejas, o si se concentran muchas piezas en la zona de solapado. Al contrario que en la estrategia b), el corte de separación aquí es total y discurre por los contornos de la pieza a la distancia definida. Las ventajas derivadas de ello son las siguientes:

1. Basta con realizar una sola perforación, lo que implica un significativo ahorro de tiempo (máxime cuando se trata de chapas gruesas).
2. Se garantiza una máxima seguridad del proceso incluso con piezas complejas, intercalados y grandes grosores de chapa.

Potencia del láser	2200 W	4400 W
Dimensión nominal de la chapa (longitud x anchura)	3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm	3000 x 1500 mm 2500 x 1250 mm 2000 x 1000 mm
Zona de corte	x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm	x = 1562 mm y = 772 mm z = 100 mm
Velocidad de posicionamiento máxima paralela al eje x, y	100 m/min	100 m/min
Velocidad de posicionamiento máxima simultánea	140 m/min	140 m/min
Divergencia de posición Pa *	± 0,1 mm	± 0,1 mm
Ancho de dispersión de posición Ps *	± 0,05 mm	± 0,05 mm
Peso de la máquina **	13 500 kg	14 600 kg
Asiento	suelo industrial estándar y armado según el plano de emplazamiento	
Cabezal de corte 5"	incluido	incluido
Cabezal de corte 7,5"	opcional	incluido
Consumo de gas de corte	según el material	
Manejo	sistema de control con pantalla táctil	
Unidades de disco	interfaz USB 1.1 en aparato de manejo	
Conexión a la red	conexión RJ45 10/100 Mbps	
ByVision (especificaciones en hoja de datos por separado)	opcional	opcional

Fuente láser de CO ₂	ByLaser 2200	ByLaser 4400
Potencia	2200 W	4400 W
Longitud de onda	10,6 µm	10,6 µm
Polarización	circular	circular
Frecuencia de impulsos	1–2500 Hz	1–2500 Hz
Grosos de chapa máx. ***		
Acero	8 mm	8 mm
Acero inoxidable	6 mm	8 mm
Aluminio	4 mm	8 mm
Consumo de electricidad de toda la instalación ****	35 kW	54 kW

* Según VDI/DGQ 3441, longitud de medición 1 m. La precisión de la pieza de chapa depende del material utilizado y de su pretratamiento, así como del tamaño de la plancha y su calentamiento.

** Instalación de corte por láser completa sin unidad combinada de refrigeración y filtrado

*** Para cortar al grosor máximo deben cumplirse las siguientes condiciones:

- Instalación de corte por láser con un ajuste y mantenimiento óptimos
- Los materiales deben alcanzar las calidades requeridas por Bystronic (materiales para láser)

**** Consumo típico unidad de refrigeración y filtro combinados incluidos

Reservado el derecho a modificaciones de cota, de construcción y de equipamiento. Certificación ISO 9001

Su contacto

www.bystronic.com